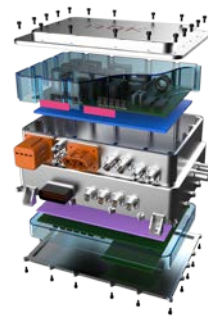


双组份导热灌封胶

GF200是一款低粘度高效导热有机硅双组份灌封胶，导热系数 $2.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，分为AB组分，按照1:1混合，混合均匀后能自排泡和常温固化，固化后具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果，可用于发热电子元件的导热封装。



特性和优点

- 导热系数 $2.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- 操作时间可调
- 高电气绝缘
- 流动性、浸润性好
- 可实现自动化作业

典型应用

- OBC, DC-DC, 连接器, 传感器, 放大器等
- LED, 电源, 功率转换器, 变压器, 高压电阻器

***操作时间:** 混合后，在操作时间内使用完毕

典型属性			
属性		典型值	测试方法
颜色(A/B)		粉色/白色	目视
粘度(mPa·s)		part A: $6,000 \pm 1,000$	ASTM D2196 @6号转子/转速100rpm
		part B: $6,000 \pm 1,000$	
操作时间(min) @25°C		60~90	A/B按1:1混合后在一起粘度上升到初始值两倍的时间
固化时间	(h) @25°C	<8	A/B按1:1混合后
	(min) @90±5°C	≤15	
流平性(mm)		≥100	@20mL/5min
固化后			
密度(g/cc)		2.4 ± 0.2	ASTM D792
硬度(Shore 00)		50 ± 10	ASTM D2240
拉伸强度(MPa)		≥0.05	ASTM D412
断裂伸长率(%)		≥30	ASTM D412
撕裂强度(N/mm)		≥0.1	ASTM D624
耐温范围(°C)		-40~150	/
防火性能		V-0	UL 94
保质期(月)		6	温度<40°C密封储存、避免暴晒
电性能			
击穿电压(kV/mm)		≥7.0	ASTM D149
介电常数 @1MHz		5 ± 1	ASTM D150
体积电阻率($\Omega\cdot\text{cm}$)		≥ 10^{11}	ASTM D257
导热性能			
导热系数($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)		2.0 ± 0.2	ISO 22007-2
热膨胀系数(ppm/°C) @-40~150°C		120 ± 15	ASTM E831-2014